

广东省科学技术厅

粤科函区字〔2024〕1239号

广东省科学技术厅关于组织参加第18届 中国西安国际科学技术产业博览会 暨硬科技产业博览会的通知

各地级以上市科技局，各有关单位：

第18届中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会（简称“西安科博会”）将于2024年11月1~3日在西安国际会展中心举办。本届西安科博会以“创新驱动发展·科技引领未来”为主题，聚焦科技领域的重点产业发展，通过成果展示、科技论坛、技术研讨、考察交流等活动形式，促进政企、行业领域开展多层次、多渠道的交流与合作。

为促进我省与中西部地区之间和国际间的科技交流与合作，培育发展新质生产力，推动产业科技融合发展，我厅将继续组织广东科技展团参加第18届中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会。现将有关事项通知如下：

一、展会时间及地点

时间：2024年11月1~3日

地点：西安国际会展中心

二、项目征集和活动策划

（一）参展项目征集

广东科技展团将聚焦低空经济、数字经济、新一代信息技术、高端装备与智能制造、生物医药、新能源、新材料等领域，面向我省实验室、高校、科研院所、企业等征集遴选一批高精尖的科技创新技术与产品。

（二）同期活动

为充分推动我省与陕西各单位间的交流合作，大会期间广东科技展团将组织参会代表参与会议活动、考察交流、项目推介路演等同期活动（详见附件1），有意向的单位一并在参展申请表（附件2）上勾选有关项。

三、展示要求

（一）参展项目技术或产品应具有合法合规的知识产权认证（自主知识产权、消化吸收创新或国内外联合研发技术等），不涉及知识产权争议或侵犯知识产权。

（二）我厅统一组团参会参展。各参展单位免展位费及设计搭建费用，参会参展人员食宿、交通等其他费用自理。

（三）有意参展单位请于10月14日17:00前，将以下材料提交至指定邮箱：

- 1.参展申请表（附件2）盖章扫描文件及可编辑Excel文档；
- 2.单位logo及二维码（矢量图）；

3.项目视频和项目相关图片 3~4 张（产品、应用场景、获奖证书等高精度图片，每张图片要求 1M 以上）。

了解大会详细情况可登录网站：www.xakbh.com。

四、联系方式

（一）省科技合作研究促进中心

黎政成，020-83549078、13078877663

丘 雅，020-83717947、15017577461

邮 箱：skjt_caijf@gd.gov.cn

（二）省科技厅成果与区域处

郭映琦，020-83163891

杨保志，020-83163862

附件：1.第 18 届西安科博会同期活动

2.第 18 届西安科博会广东科技展团参展申请表

省科技厅

2024 年 9 月 27 日

公开方式：主动公开